

WB-860T 半自动压焊机



WB-860T 是适合于特殊电子元器件封装生产中芯片内部引脚互连工艺应用的专用设备，是电子元器件封装生产中关键设备之一。

WB-860T 根据工艺需要可配置为球焊、楔焊、深腔压焊功能的半自动压焊机。

应用范围

混合电路、COB 模块
MCM、MEMS 器件
RF 器件/模块
光电器件
微波器件

功能

球键合
30°、45°、60° 楔键合
90° 深腔键合
凸点制作
连焊
自动焊接一、二焊点

主要技术特点：

键合头机构：采用音圈电机提供压力，键合压力可控。

X-Y-Z 台机构：采用直线导轨结构，具有很高的定位精度。

升降台机构：采用四连杆机构，垂直升降。

主要技术指标：

键合头

自动 Z 行程：12.7mm

自动 Y 行程：12.7mm

手控 X-Y 范围：15.5mm×15.5mm（比率 8:1）

升降台 Z 行程：18mm



升降台 X-Y 范围：250mm×270mm

超声波功率：0-3w/0-5w

程控压力范围：10g-50g/10g-100g

焊线直径：铝线 20 μ m-76 μ m

金线 17 μ m-50 μ m

打火装置：N-EFO（-3500V）

成球大小：焊线直径的 1.5 倍到 4 倍

供线装置：1/2”

热台温度：室温-300℃

操作菜单：7” TFT 彩屏，中文菜单

电源：AC220V±10%（50/60Hz）≤500W

外形尺寸：650×700×400mm

重量：约 50kg

📌 标准配置

主机

1/2” 线轴

LED 照明灯

体视显微镜

进口换能器

夹持台

温控盒（铝丝楔焊无）

📌 可选附件

各种特种夹持台

劈刀加热配件（~300℃）

各种劈刀及金线、铝线

工具包（克力计、镊子等）

打火盒（楔焊无）

📌 选购须知

WB-860T 是半自动压焊机的基本型号，根据功能配置可分为：

球焊配置机型（Q 型）

楔焊配置机型（X 型）

0° 深腔楔焊机型（S 型）